

证券代码：002989

证券简称：中天精装

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年05月08日 15:30-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 楼峻虎 董事、总经理 王新杰 董事、联席总经理 张安 董事、财务负责人 陶阿萍 董事会秘书 李丽 独立董事 郜树智 独立董事 舒杰敏 独立董事 伍安媛
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问王总，3月成立的中天数算主要是出于什么目的？重点是什么业务？未来3-5年有什么目标？谢谢！ 答:尊敬的投资者您好！2025年，公司重点以应用场景为牵引，整合半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造以及AI算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，逐步打造在半导体领域的核心竞争力和市场地位。感谢您的关注与支持！

	2. 公司半导体业务是否已经投产？目前是否有合作客户？ 答:尊敬的投资者您好！公司参股的半导体项目科睿斯半导体科技（东阳）有限公司尚在建设中，未开始生产经营；合肥鑫丰科技有限公司已有厂房处于满产状态，正在扩大产能；深圳远见智存科技有限公司的HBM2/2e产品已完成量产、终试和升级，HBM3/3e产品尚在开发阶段。感谢您对公司的关注与支持！
	3. 董事长你好，咱们公司在今年一季度又注册成立了浙江中天数算科技有限公司，请问成立这个公司的目的和此公司在未来的定位是什么？能否在今年承接相关业务？ 答:尊敬的投资者您好！2025年，公司重点以应用场景为牵引，整合半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造以及AI算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，逐步打造在半导体领域的核心竞争力和市场地位。感谢您的关注与支持！
	4. 控股股东或者公司高管是否有增持计划？ 答:尊敬的投资者您好！如涉及，公司及相关信息披露义务人将根据相关法律法规要求及时披露相关情况，具体以公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告为准。感谢您的关注与支持！
	5. 公司实控人变更为东阳国资办后，是否有优质资产注入，未来国资方对公司的发展战略有怎样的规划和期望？ 答:尊敬的投资者您好！公司充分依托实际控制人东阳国资办及战略股东的强势资源整合能力，精准捕捉市场趋势，果断布局半导体前沿领域。通过深入的市场调研与专业的团队筹备，逐步涉足半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造等细分领域。此举旨在为公司打造第二业务增长曲线，降低对公司原有主业单一精装修业务的依赖，最终实现双轮驱动发展，提升未来公司整体抗风险能力与市场竞争力。感谢您的关注与支持！
	6. 为应对业绩下滑，公司采取了审慎经营策略，强化现金流

	管理，优化项目结构，主动收缩高风险项目规模，这些措施实施后，目前公司现金流状况如何？后续还会采取哪些手段来保障现金流稳定？ 答:尊敬的投资者您好！公司始终坚持收款为先。首先，公司将强化现金流管理作为核心战略，秉持“现金为王”理念，制定加强与优质客户合作、强化应收账款回收等举措，以增强抗风险能力，形成良好的业态环境，全面夯实公司经营稳定性；其次，设立资产管理部，专项推进资产处置，加大盘活公司资产的力度，减少对公司资金的占用，保障公司现金流安全；再次，修炼内功，提升施工质量、提升客户口碑，提高业务的标准化程度、提高公司盈利能力；最后，公司将继续优化内部治理结构、优化人才管理机制，挖潜降本增效管理方式，推进企业信息化管理系统建设，降低公司资源消耗、提高运行效率。感谢您的关注与支持！ 7. 公司在2024 —2025年多次发布拟出售资产的公告，拟出售总金额不超过4亿元，目前资产出售进展如何？出售资产获得的资金将如何使用，对公司债务偿还和业务发展有什么具体规划？ 答:尊敬的投资者您好！公司出售资产的相关事宜正在有序推进中，其产生的影响已体现在公司财务报表中，公司将合理配置资源，确保资金使用效益最大化。感谢您的关注与支持！ 8. 公司在近期投资者关系活动中表示会围绕国家战略新兴产业，重点关注半导体领域，除了目前已开展的项目，未来还会在半导体哪些细分领域进行布局？ 答:尊敬的投资者您好！2025年，公司重点以应用场景为牵引，整合半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造以及AI算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，逐步打造在半导体领域的核心竞争力和市场地位。感谢您的关注与支持！ 9. 截至2024年末，公司应收款项融资较上年末减少48.75%，
--	---

这对公司资金回笼和运营有什么影响？

答:尊敬的投资者您好！公司应收款项融资的减少主要系应收账款收回及坏账计提增加导致余额减少，公司将强化现金流管理作为核心战略，秉持“现金为王”理念，制定加强与优质客户合作、强化应收账款回收等举措，以增强抗风险能力，形成良好的业态环境，全面夯实公司经营的稳定性。感谢您的关注与支持！

10. 董秘你好，你提到的公司未来目标：整合半导体ABF载板，先进封装，HBM存储等资源，是否有大体的行动规划？是否可以理解为未来会把公司投资的三个相关公司科睿斯，远见智存，鑫丰科技，全部装入上市公司中，以达到整合的目的？谢谢告知。

答:尊敬的投资者您好！公司将根据相关法律法规要求及时披露相关情况，具体以公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告为准。感谢您的关注与支持！

11. 公司2024年营收下降56.0%，归母净利润亏损4.28亿元，同比下降5239.2%，能详细分析下导致业绩大幅下滑的具体原因吗？

答:尊敬的投资者您好！这主要系公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备；公司为防范回款风险，加强了对承接项目及客户的甄选力度，主动收缩了业务规模；受市场竞争环境等因素影响，客户对成本管理更趋严格，导致公司项目毛利率下降。公司在强化装饰装修业绩的同时，审慎布局半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造等新兴领域，以进一步增强公司的综合实力和可持续发展能力，为未来长期稳健发展创造更多可能。感谢您的关注与支持！

12. 公司2024年研发投入金额为1211.93万元，同比下降57.08%，在积极拓展新业务的情况下，研发投入却大幅下降，是出于什么考虑？后续对半导体和装饰装修业务的研发投入计划是怎样的？

	答:尊敬的投资者您好! 此前公司的研发投入是围绕批量精装修业务开展, 主要是数字化系统研发投入和升级改造, 近两年该部分业务规模主动缩减比例较大, 导致对应研发投入减少。 2024年度内, 公司对半导体新业务的投入采用权益法核算, 未纳入合并报表范围。后续公司将根据业务发展需求及战略性布局等因素, 合理安排研发投入资金。感谢您的关注与支持!
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	
日期	2025年05月08日